

Matériel de soudage et brasage

Solder wire S-Sn99cu1 2.5% 2 mm 500 g lead free

160454



haupa®

Solder wire S-Sn99cu1 2.5% 2 mm 500 g lead free

	160454
Matériau	Étain/cuivre
Teneur en étain	99 %
Diamètre	2 mm
Poids	500 g
Finition avec fondant	Oui
Part de fondant	2.5 %

Marque	HAUPA
Art. N°	160454
Unité de vente	pc
EAN PCE	4011923180010
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	83113000